

# 2024 法人說明會

總經理 黃道景 2024.11.28

股票代號：3444

發言人：盧修滿協理 / [claire@niching.com.tw](mailto:claire@niching.com.tw)

代理發言人：邱智芳協理 / [chris@niching.com.tw](mailto:chris@niching.com.tw)

股務聯絡人：陳玲芝課長 / [cherry@niching.com.tw](mailto:cherry@niching.com.tw)

# 投資安全聲明



本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。

# 公司簡介

創立：1993年

資本額：4.5億

上櫃時間：2008年

營業據點：



台中總公司



新竹分公司

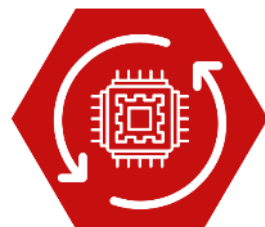


高雄分公司



蘇州分公司

營業項目：



## 通路代理

半導體、FPD、LED相關材料、  
零件與設備

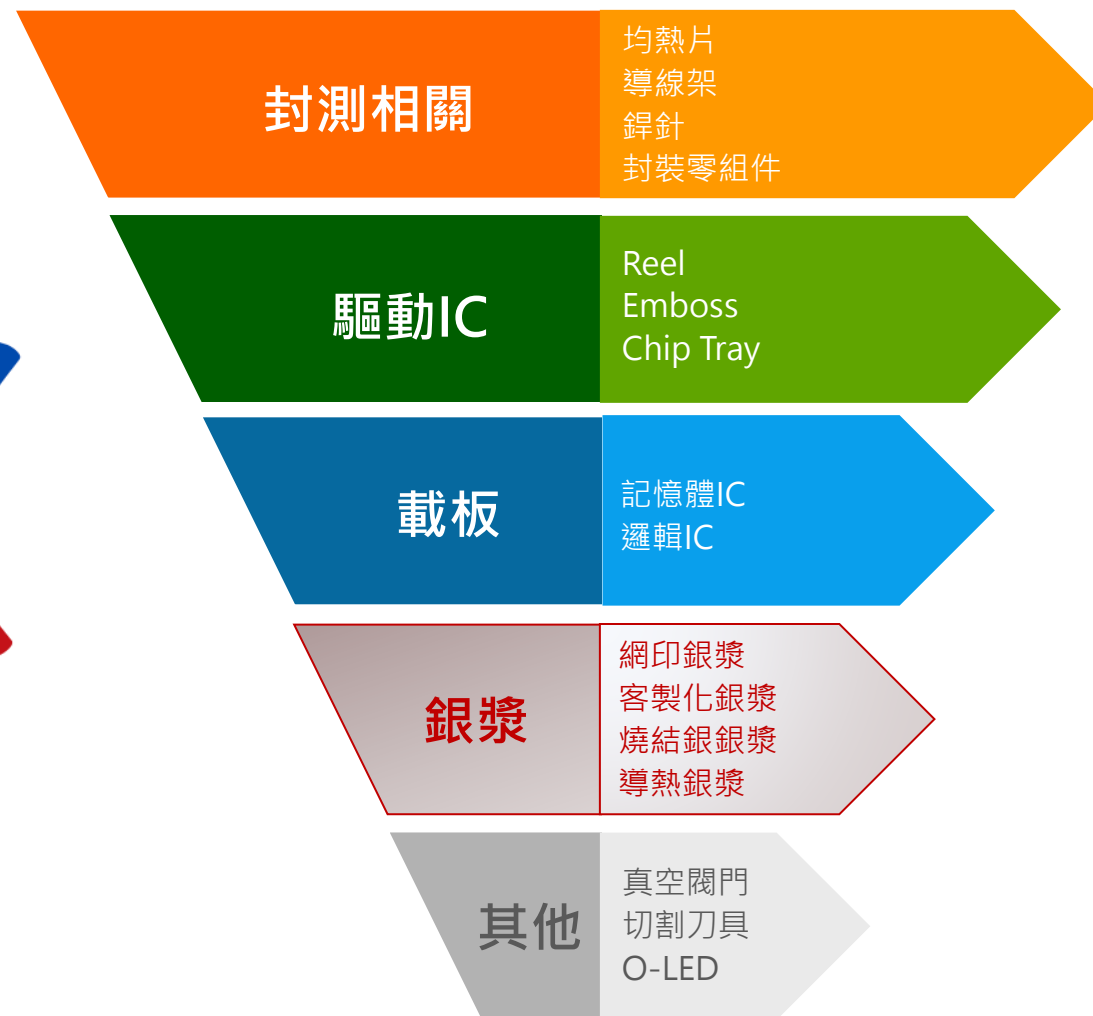


## 自有研發與製造

1. 低溫燒結銀膠
2. 高導熱銀膠
3. 網印銀漿
4. 客製化銀漿

# 營運三布局 (1/2)

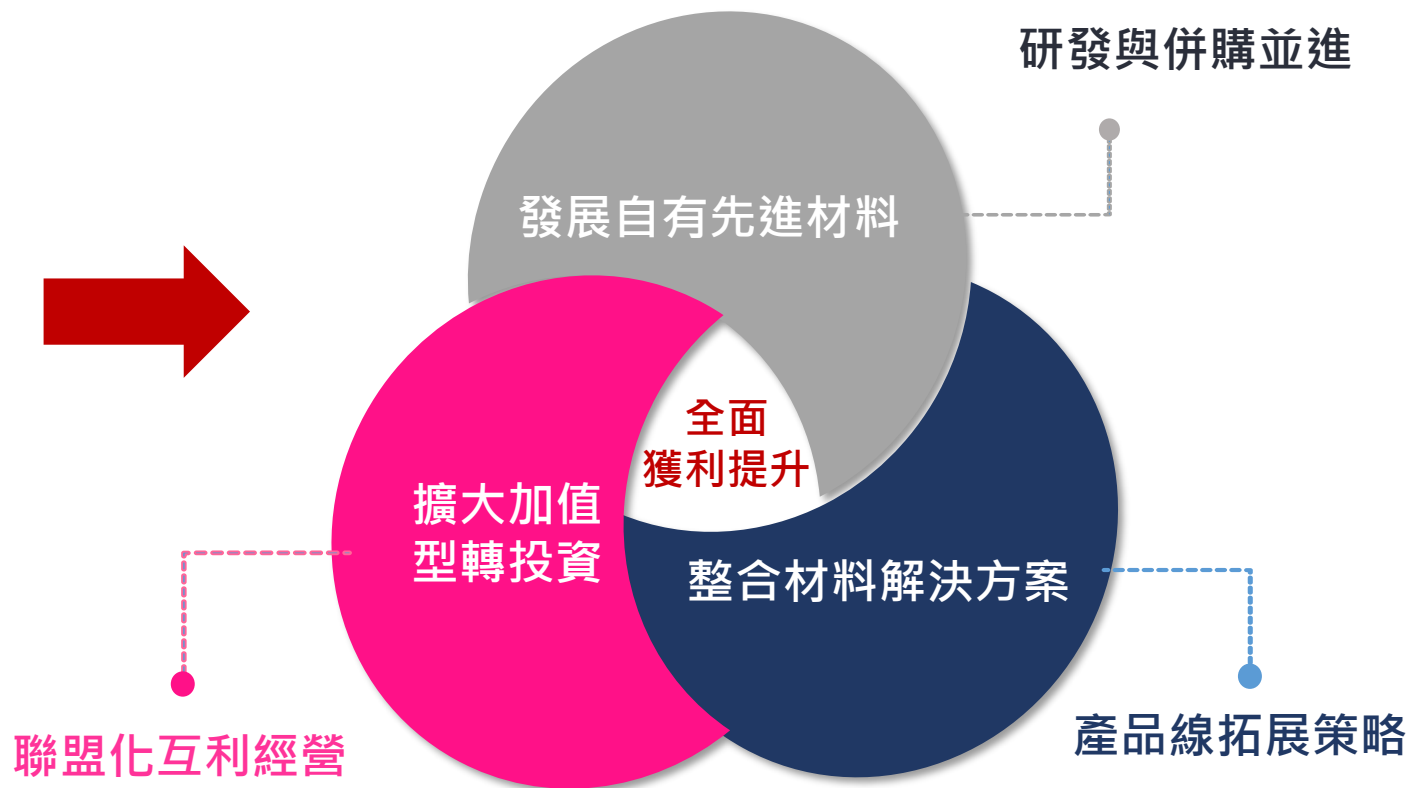
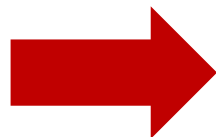
代理商 → 整合型材料供應商



# 營運三布局 (2/2)

代理商 ➔ 整合型材料供應商

轉型全面提升獲利





# 營運報告

# 綜合損益表



- EPS下滑主因：一次性認列STNC歷年轉投資收益所得稅(減少EPS0.37)、匯兌損失
- 本業之營業淨利QoQ 28%, YoY 31% , 整體營運仍屬向上趨勢。

(NT\$仟元)	2021	2022	2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	累計至Q3	Q3 2024		累計至Q3
								QoQ	YoY	2024
								YoY	YoY	YoY
營業收入	1,218,919	1,060,398	976,397	238,074	301,397	304,539	844,010	1%	17%	16%
營業毛利	310,457	310,949	255,756	63,037	73,889	79,153	216,079	7%	16%	13%
毛利率	26%	29%	26%	26%	25%	26%	26%	0%	0%	0%
營業淨利	150,568	124,057	75,279	13,241	21,977	28,235	63,453	28%	31%	21%
營業外收(支)	15,294	110,067	36,565	23,801	14,426	(717)	37,510	-105%	-103%	-33%
稅前淨利	165,862	234,124	111,844	37,042	36,403	27,518	100,963	-24%	-40%	-6%
本期淨利	134,428	195,976	93,545	31,079	33,013	7,273	71,365	-78%	-81%	-22%
淨利率	11%	18%	10%	13%	11%	2%	8%	-78%	-84%	-32%
EPS (NT\$) 註:	3.36	4.90	2.12	0.69	0.73	0.16	1.59	-78%	-13%	-24%

註：係追溯調整後

# 資產負債表



NT\$仟元	2021	2022	2023	Q3 2024
<b>資產</b>				
現金及約當現金	279,765	327,431	398,797	299,668
應收帳款	509,553	532,247	443,432	511,532
存貨	66,764	60,048	67,008	53,267
轉投資相關	205,830	257,247	263,434	236,669
不動產、廠房及設備	228,528	226,154	223,341	284,479
其他資產	23,817	26,539	34,288	36,207
<b>資產總計</b>	<b>1,314,257</b>	<b>1,429,666</b>	<b>1,430,300</b>	<b>1,421,822</b>
<b>負債</b>				
短期借款	126,429	150,000	-	10,000
應付帳款	265,051	227,968	233,559	265,694
其他負債	115,613	131,435	110,272	99,407
<b>負債總計</b>	<b>507,093</b>	<b>509,403</b>	<b>343,831</b>	<b>375,101</b>
<b>權益總計</b>	<b>807,164</b>	<b>920,263</b>	<b>1,086,469</b>	<b>1,046,721</b>
淨值 ( NT\$元 )	20.64	23.53	24.63	23.26



# 歷年營收/接單金額

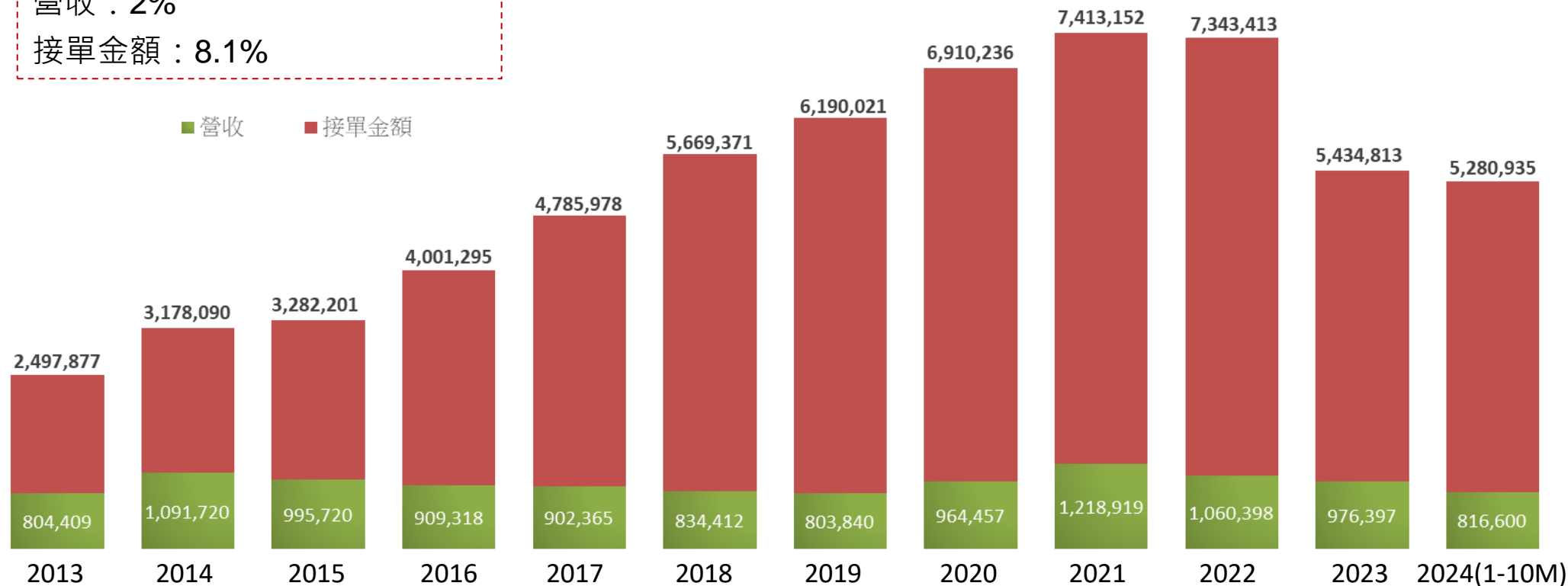


2013-2023 CAGR(複合成長率)

營收：2%

接單金額：8.1%

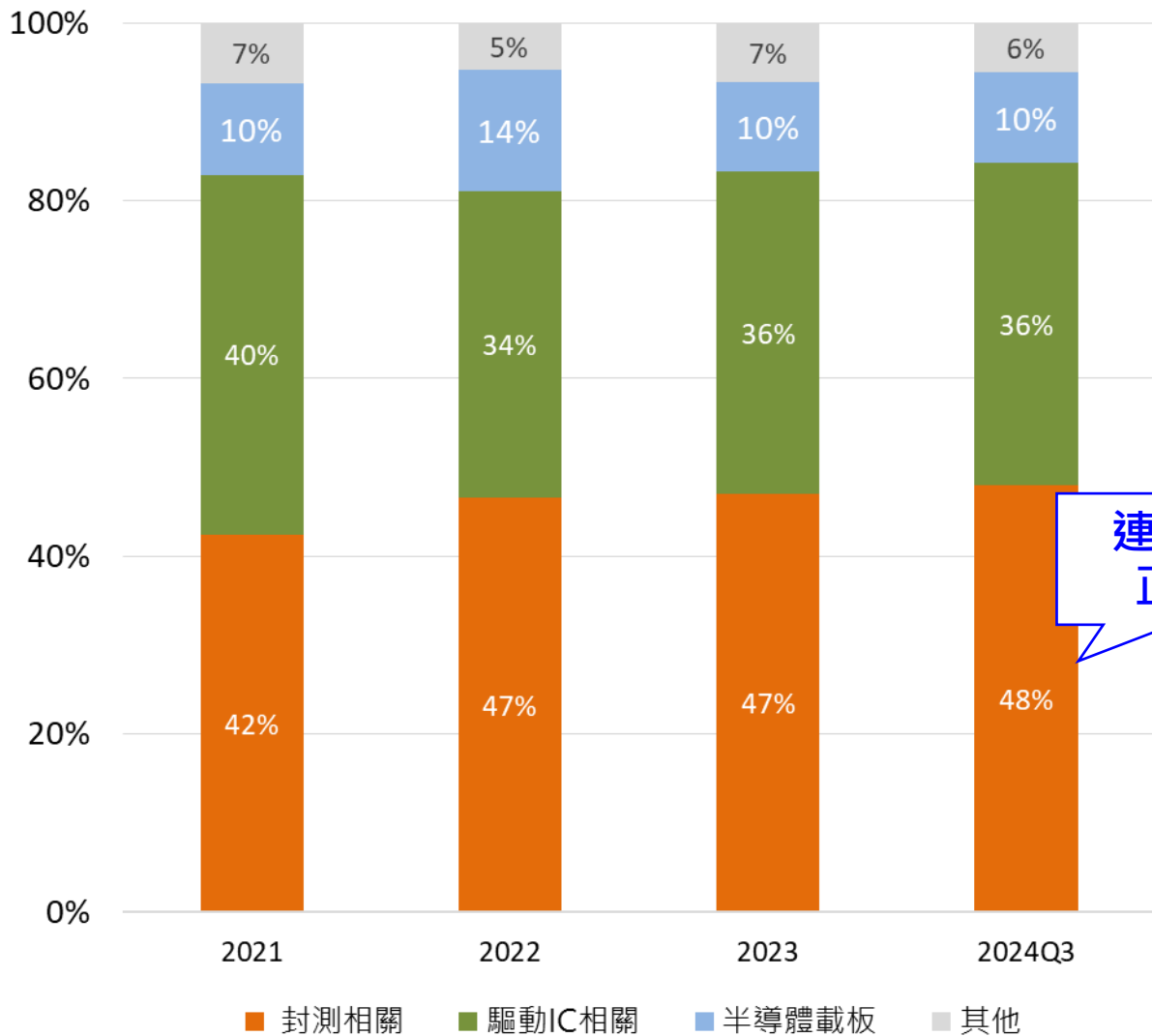
單位：仟元



說明： 營收模式：分為買賣模式(營收全部認列)及佣金模式(僅佣金收入認列)

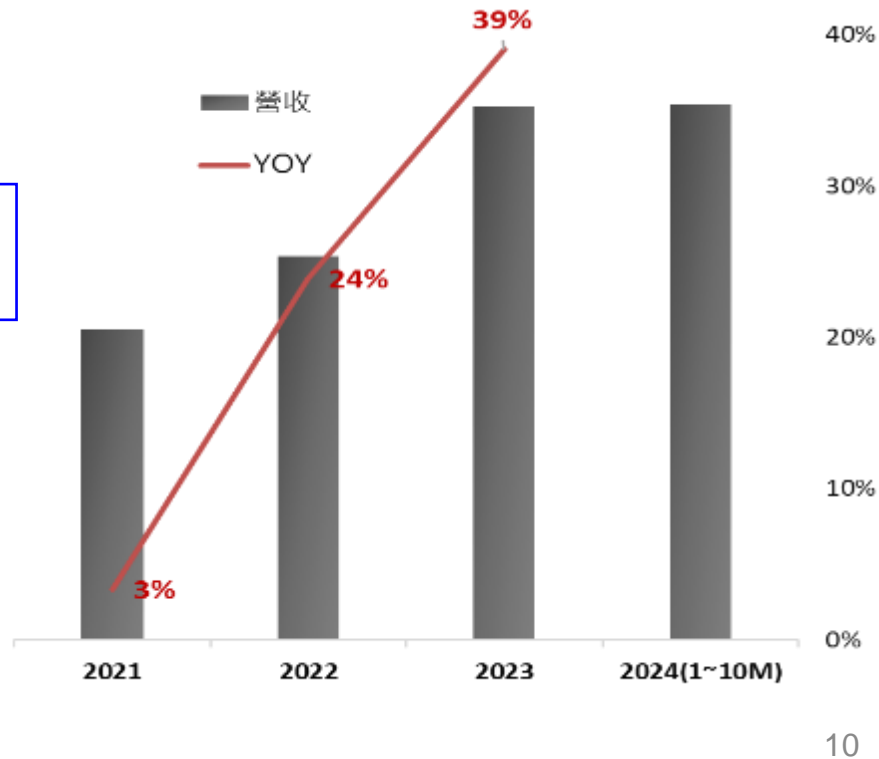
接單金額=訂單總金額(銷售模式+佣金模式)

# 產品別營收佔比



連續三季  
正成長

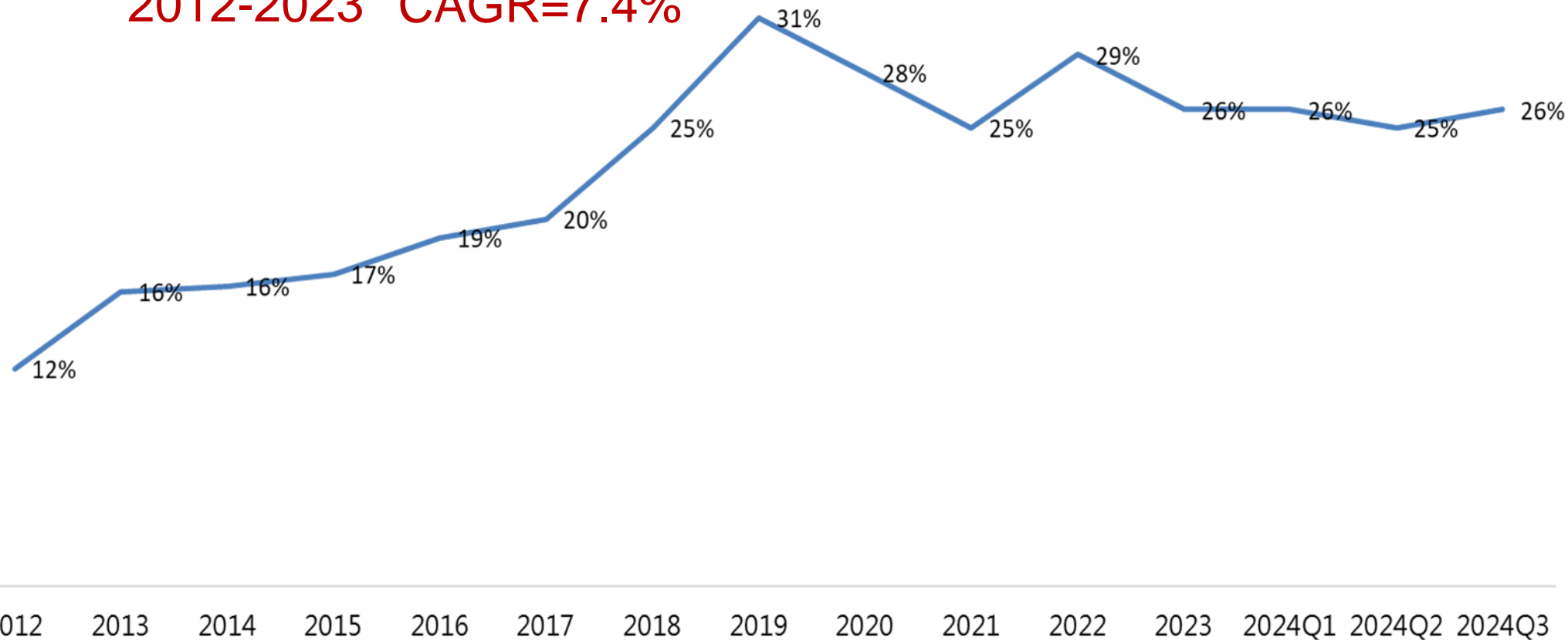
## 銀漿營收成長



# 歷年毛利率



2012-2023 CAGR=7.4%

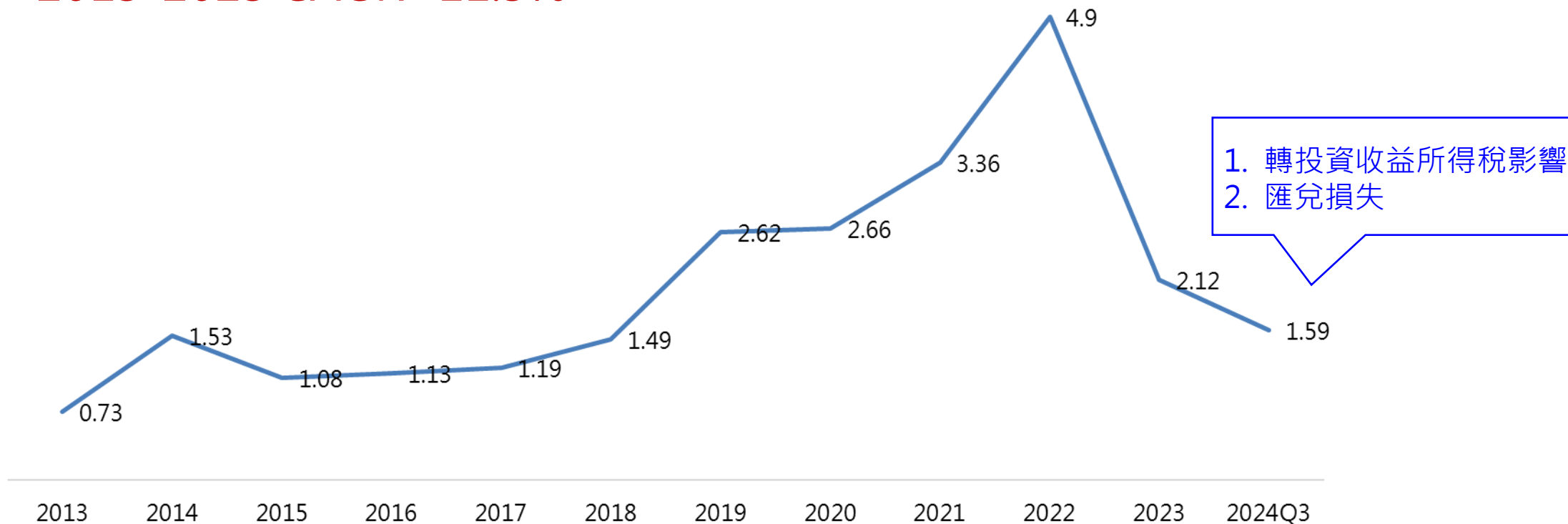


# 歷年每股稅後盈餘

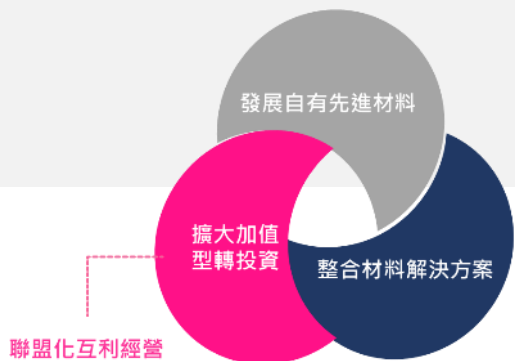


單位：元

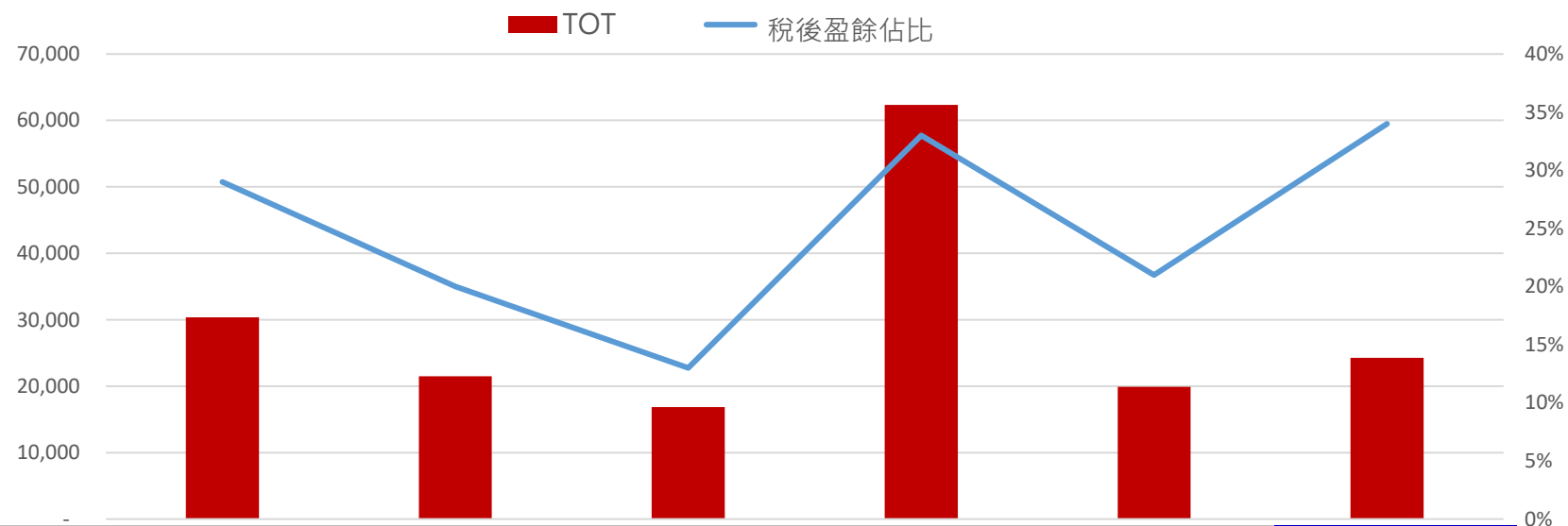
2013-2023 CAGR=11.5%



# 現有三大加值型轉投資長期穩定貢獻獲利



Simmtech 蘇州(STNS)已由成本中心轉為利潤中心，佣金率提高。  
利機3月底持股由30%提升至49%。



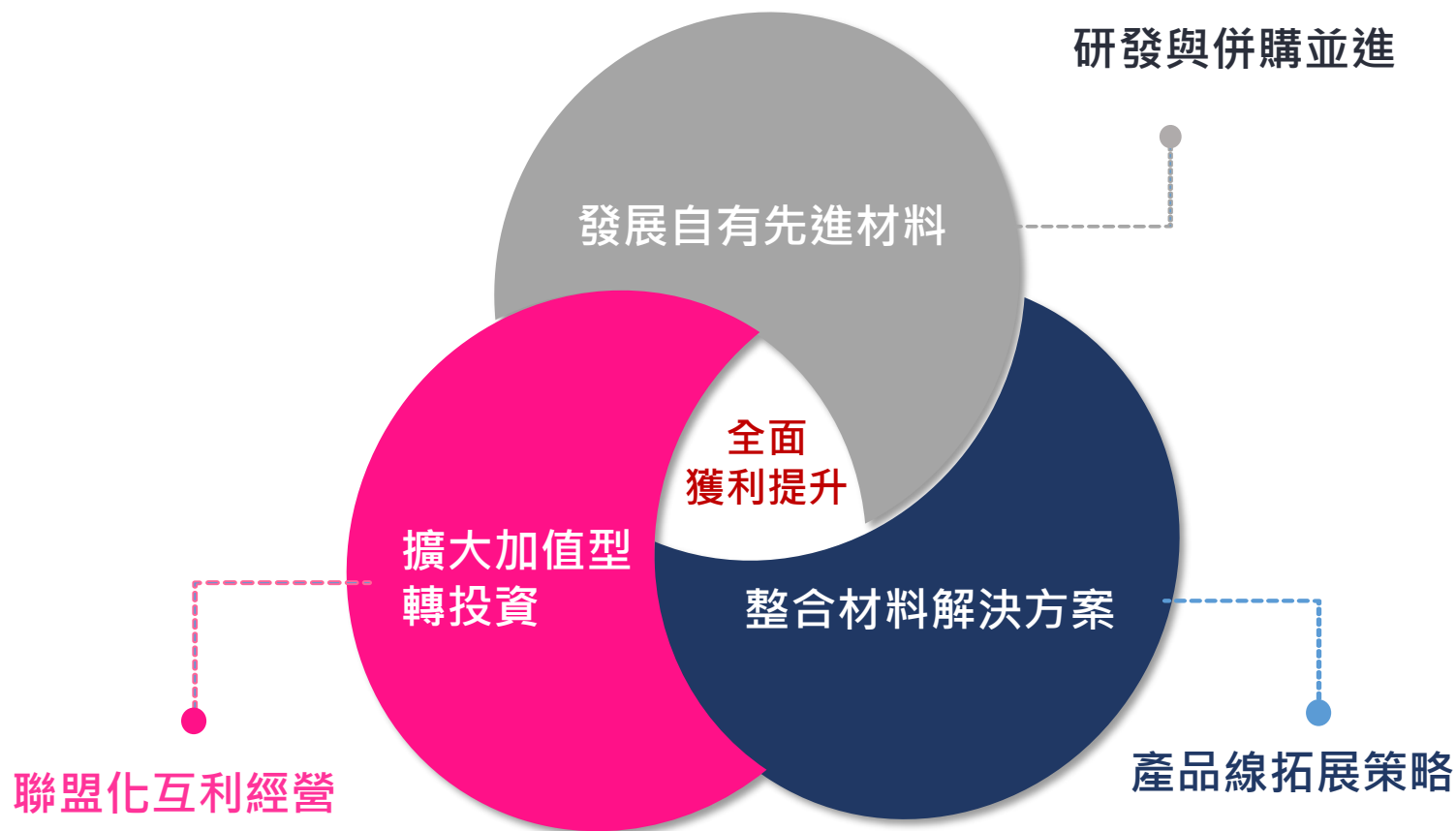
(NT\$千)	2019	2020	2021	2022	2023	2024Q3
精材	1,680	1,344	1,680	2,351	1,008	1,680
STNC	12,799	5,493	669	10,007	(3,521)	7,440
ENT	15,904	14,669	14,485	49,965	22,434	15,142
<b>TOT</b>	<b>30,382</b>	<b>21,506</b>	<b>16,834</b>	<b>62,323</b>	<b>19,922</b>	<b>24,262</b>
稅後盈餘佔比	29%	20%	13%	33%	21%	34%

已達2023全年的122%



# 營運展望

## 轉型全面提升獲利



# 布局一：整合材料解決方案

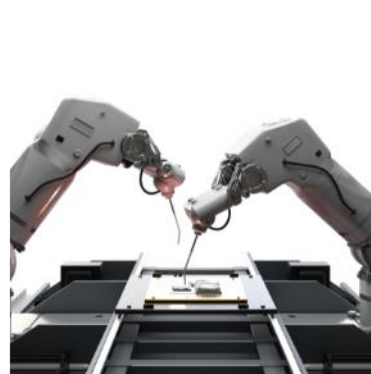
## 「高功率」與「散熱」應用需求增長



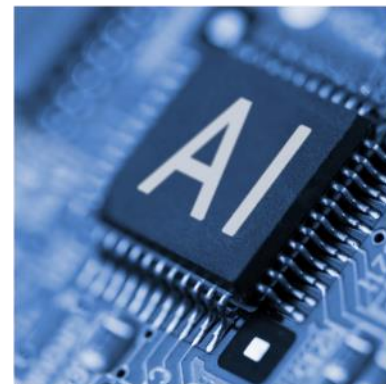
車用



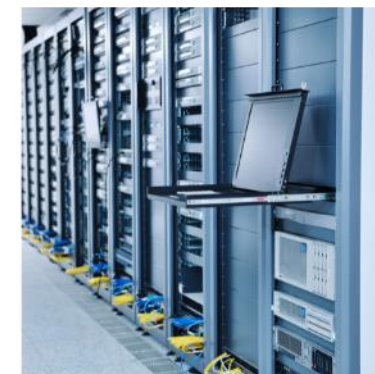
通訊



工業用



AI



HPC



電網

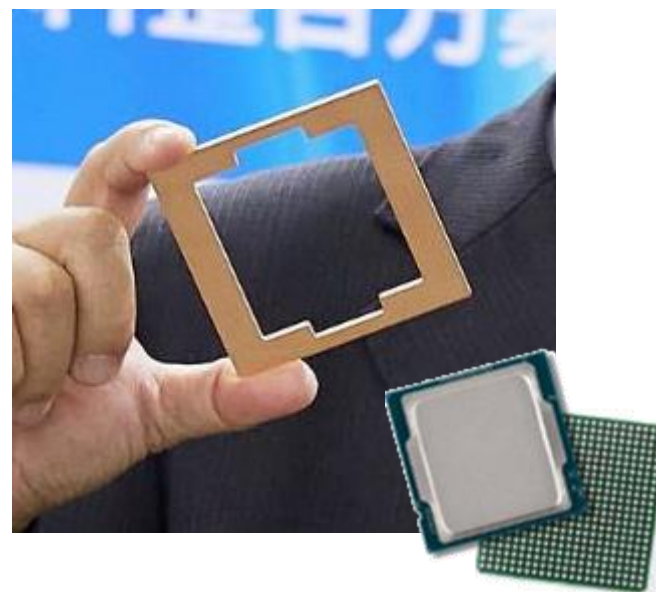


## IC散熱解決方案

銀漿



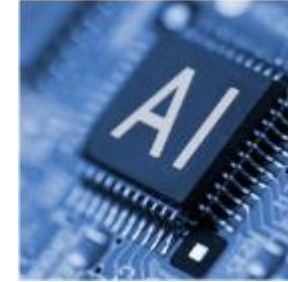
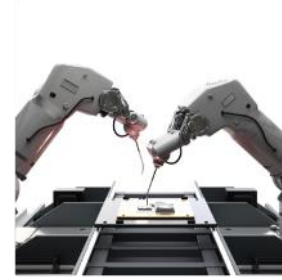
均熱片



# 布局一：整合材料解決方案



## IC散熱解決方案 滿足高功率與散熱市場需求

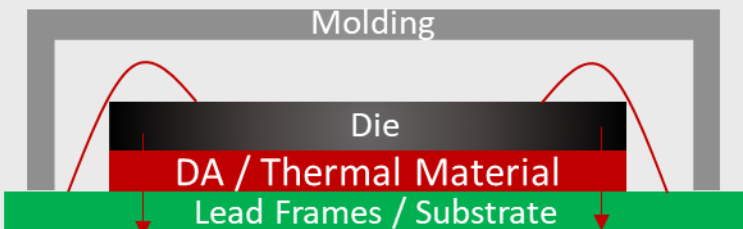


**Die Attach Paste**  
(導熱銀膠、燒結銀膠)

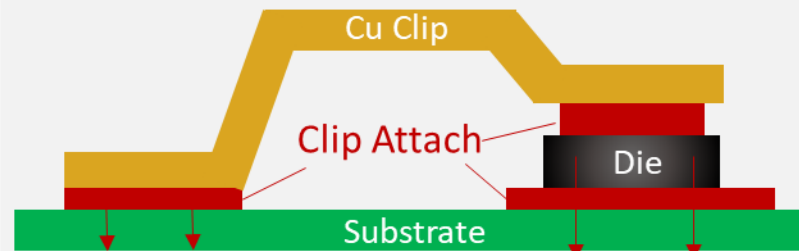
**Clip Attach Paste**  
(燒結銀膠)

**TIM1、Heat Sink**  
(燒結銀膠) (均熱片)

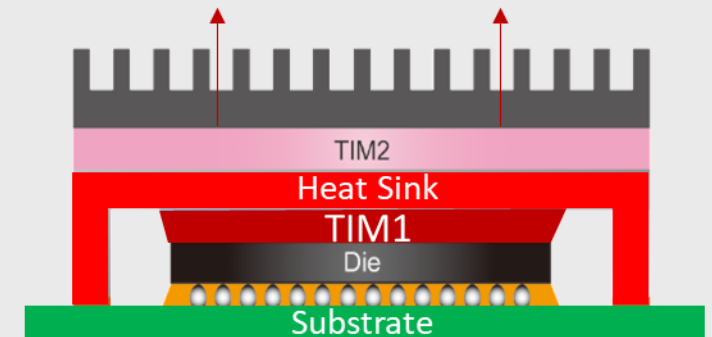
Wire Bond Package



Clip Package

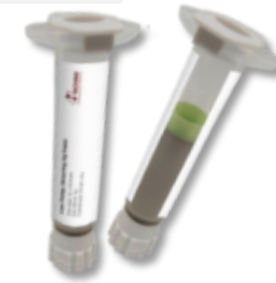


Flip Chip Package



# 布局二：發展自有先進材料

## 1 自有銀漿研發 技術創新與突破



車用電子

高功率LED

IGBT

MOSFET

IOT



1. 高附著強度
2. 高信賴性



1. 超高散熱性  
( $>200$  W/MK)
2. 高信賴性



1. 適用大尺寸  
( $>8 \times 8$  MM) 晶片
2. 超高散熱性  
( $>200$  W/MK)

技術  
新突破



1. 高導熱性
2. 高韌性
3. 高信賴性



1. 快速固化
2. 高導電性

# 布局二：發展自有先進材料

## 1 自有銀漿研發 利機競爭優勢



關鍵材料  
自有研發

專注  
投入

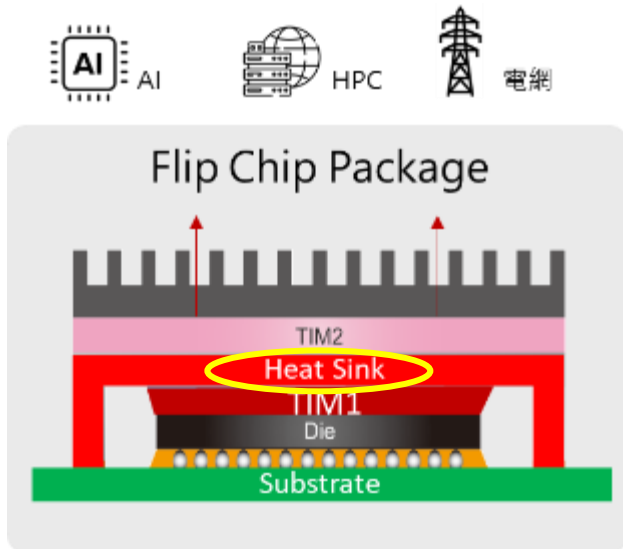


客製化  
能力

# 布局二：發展自有先進材料

## 2 均熱片布局趨完整

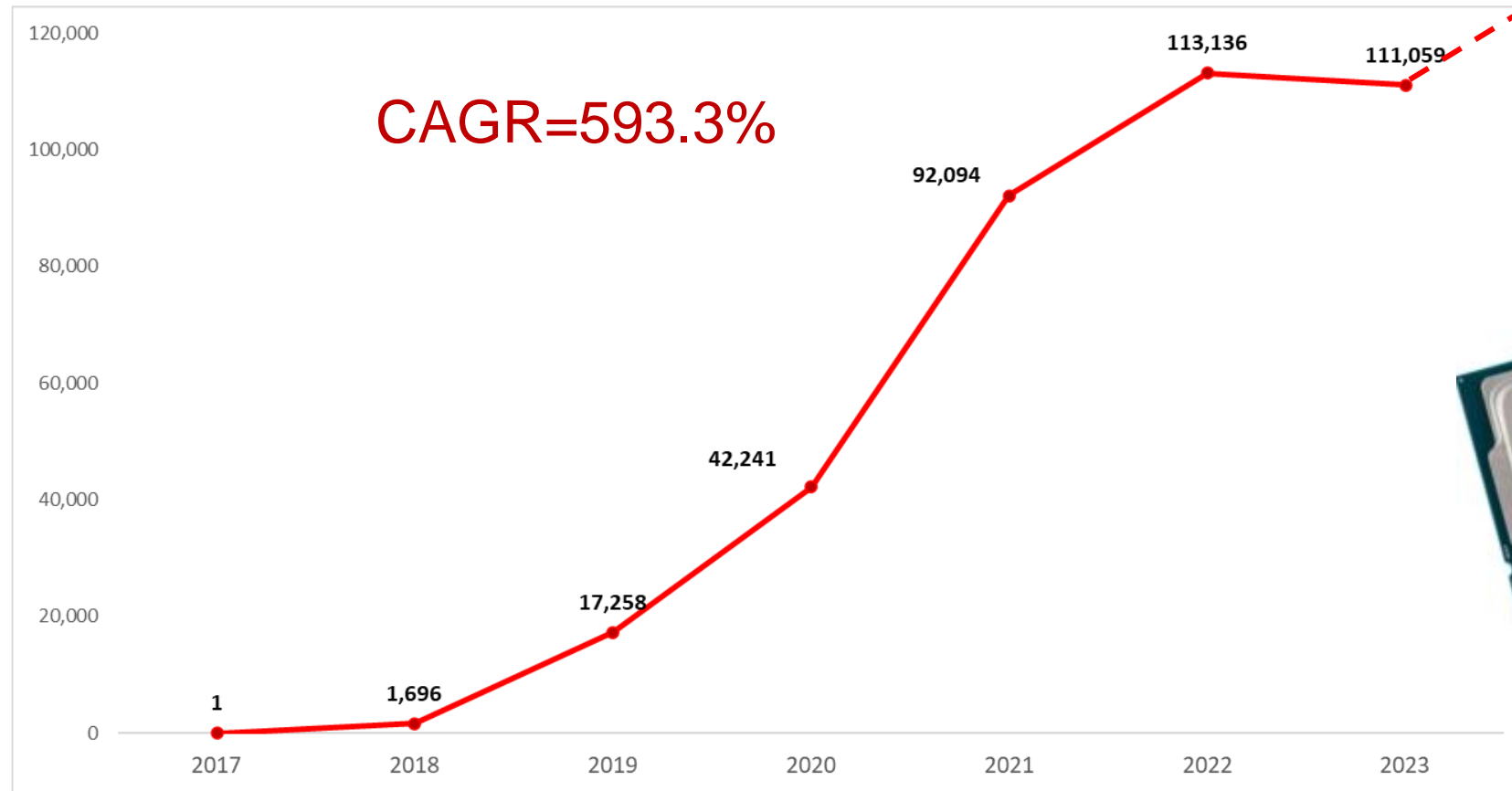
1. 尺寸齊全、客製化生產，2024年聚焦大尺寸、先進封裝。
2. 2024/10完成均熱片廠商之轉投資案，配合發展性初步持股6%，未來持續布局電解電鍍鎳製程，將可承接所有封裝客戶需求，服務更全面性。



應用領域	尺寸	技術門檻	售價	利機優勢
消費性 IC	小片	低	低	• 具 銅材/鋁材/不鏽鋼 高精 密沖壓技術，客製化生產 • 台系封裝廠的合格供應商
Wireless AP	大片 40*40mm以上	高	高	
伺服器				
CPU/GPU				

# 均熱片歷年營收

單位：仟元



YOY > 10%



- 一. 2024年前三季營收逐季成長向上，預估全年營收將優於2023年。
- 二. 銀漿產品-聚焦高功率元件、高運算散熱。客製化銀漿技術有新突破，對標國外競爭對手，交期與供貨具有競爭力。2025年將有新產品進入量產。
- 三. 新產品-營運成長新動能
  - 1) 閥類-蝶閥正式取得電漿設備大廠訂單。
  - 2) 切割刀-package saw有望取得與封裝大廠合作機會。
- 四. 加值型轉投資-累計至Q3投資收益已達2023全年的122%，貢獻利機2024年度整體獲利。



# THANK YOU

